**國家中山科學研究院飛彈火箭研究所**

**107年第三次專案人力進用招考甄試簡章**

**研發類延長公告**

**壹、員額需求：**

107年第三次專案人力進用：研發類64員、技術類89員，共計153員(如附件1員額需求表）。

**貳、薪資及待遇：**

一、薪資：各單位依招考公告薪資總額基準表面議，惟薪資總額區分基本薪及變動薪，基本薪依公告職缺之限定學歷核給，其餘金額列入變動薪。

二、福利、待遇：

(一)享勞保、健保及依勞工退休金條例第14條按月提繳退休金。

(二)可申請員工宿舍。

(三)年終工作獎金之發放，依本院訂頒之「年終工作獎金發放作業規定」及「員工工作規則」辦理。

(四)因任務需要超時工作，依本院「員工工作規則」辦理。

(五)詳細待遇及權利義務內容於本院「勞動契約」訂定之。

(六)軍公教退伍(休)轉任人員，薪資超過法令所訂基準(含主管加給、地域加給)，依法辦理。

(七)公務人員退休人員再任本院員工，依「公務人員退休法及其施行細則」規定辦理。

(八)退休教職員再任本院員工，依「學校教職員退休條例及其施行細則」規定辦理。

**參、報考資格：**

一、國籍：具中華民國國籍，並在臺灣、澎湖、金門、馬祖地區設有戶籍者。

二、學、經歷：教育部評鑑合格之各大學院校相關系所畢業(**持國外學歷者，需符合教育部頒「大學辦理國外學歷採認辦法」之資格**)

(一)研發類：

1.碩士(含)以上畢業，其學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件者。學歷認定以員額需求表所需學歷之畢業證書記載為準，如非理、工學院畢業者，其理工相關課程學分需超過總學分三分之二以上，同時論文題目需與理、工相關，且為本院研發任務所需之專長；前述理、工相關課程學分需超過總學分三分之二以上之規定，可檢具論文、成績單及學校開立證明書認定，或檢具學分證明資料由本院專業單位審查。

2.非理工學院之特殊領域相關系所碩士(含)以上學歷畢業之特殊人才，依本院「特殊領域人才進用作業規定」(如附件4)審認。

3.同等學力不予運用。

4.報考人員若高於該職缺「學歷」，仍依員額需求表薪資範圍核薪。

(二)技術類：

1.高中、職(含)以上學歷畢業。

2.學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件者。

3.同等學力不予運用。

4.報考人員若高於該職缺「學歷」，仍依員額需求表薪資範圍核薪。

三、其他限制：具有下列情形之一者，不得辦理進用；若於進用後本院始查知具下列限制條件者，因自始即未符合報考資格，本院得取消錄取資格，並不得提出異議︰

(一)大陸地區人民、香港居民或澳門居民。

(二)無行為能力或限制行為能力者。

(三)曾因違反毒品危害防制條例案件，受觀察勒戒、強制戒治及刑之宣告者。

(四)犯內亂、外患、貪污罪及違反國家機密保護法，經判決有罪者。惟情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(五)曾犯前款以外之罪，經判處有期徒刑以上之刑，尚未執行或執行未完畢者。惟情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(六)因案被通緝或在羈押、管收中。

(七)依法停止任用者。

(八)褫奪公權尚未復權者。

(九)受監護宣告尚未撤銷者。

(十)於本院服務期間，因有損本院行為，遭解僱或以不勝任人員資遣者。

(十一)本院各級主管之配偶及三親等以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避任用。

(十二)因品德、操守或違反資安規定遭任職單位核予大過(含)以上之懲罰者。

**肆、報名時間及方式：**

1. 簡章及職缺需求刊登於本院全球資訊網 (<http://www.ncsist.org.tw>)，公告報名至**107年08月09日止;研發類延長公告至107年08月27日**。
2. 符合報考資格者，需至本院網路徵才系統(https://join.ncsist.org.tw) 填寫個人資料及上傳履歷表(貼妥照片，格式如附件2)、學歷、經歷、成績單、英文檢定證明、論文、期刊發表、證照、證書等相關資料後，選擇報考職缺並投遞履歷，**各項資料請依序彙整在同一檔案(PDF檔)上傳**。
3. 本所於本院徵才系統資料庫搜尋並篩選符合報考資格者後，辦理書面審查(或資格審查)。
4. 報考人員經書面審查(或資格審查)合格者，本所以**電子郵件或簡訊**通知參加甄試。
5. 不接受紙本報名及現場報名。
6. 若為本年度應屆畢業生或延畢生(報名甄試時尚未取得畢業證書者)，報名時請檢附學生證掃描檔供查驗。前述人員於錄取後，需於本院寄發通知日起3個月內(報到前)，繳交畢業證書掃描檔供查驗，若無法於時限內繳交或與報名時提供之資料不符者，則取消錄取資格。
7. 歡迎具身心障礙身分或原住民身分且符合報考資格者報名參加甄試，請於報名之履歷表上註記。
8. 為提供本院聘雇員工職類轉換管道，本次招考開放院內符合報考資格之員工，可報名參加甄試。本院員工報名甄試者，不可報考同一職類，且需經單位一級主管同意後(報名申請表如附件3)，於本院網路徵才系統完成報名。另當事人需填具工作經歷(非職稱)後，由該工作經歷任職單位二級主管核章，無需檢附勞保明細表。

**伍、報名應檢附資料：報名資料未繳交齊全或資料內容無法辨識者，視同資格不符。各項資料務必依序彙整於同一檔案(PDF檔)後再上傳。**

1. 履歷表：**請依照附件2格式填寫**。並請依誠信原則，確實填寫在本院服務之親屬及朋友關係，若未誠實填寫而錄取，本院得予不經預告終止契約解除聘雇。
2. 符合報考學歷之畢業證書掃描檔。
3. 報考所需之個人相關掃描檔資料(如：符合報考學歷畢業證書、工作經歷證明、證照、成績單或英文檢定成績等)，請參考簡章之員額需求表。
4. 提供工作經歷證明者，格式不限，但需由公司蓋章認可，內容需註明從事之工作內容(非職稱)及任職時間。
5. 若有繳交民營機構之工作經歷證明，需再檢附「勞保投保明細表」，未檢附者，該工作經歷不予認可。
6. 具身心障礙身分者，檢附身心障礙手冊(證明)正、反面掃描檔。
7. 具原住民族身分者，檢附戶口名簿或戶籍謄本掃描檔，並標記族別。
8. 主管核章之申請表正本(如附件3)，僅本院同仁需繳交。

**陸、甄試時間、地點及方式：**

1. 甄試日期：暫定於**107年08-09月**舉辦(實際甄試時間以甄試通知為準)。
2. 甄試地點：暫定於桃園市龍潭區中科院新新院區(實際甄試地點以甄試通知為準)。
3. 甄試方式：

(一)研發類：

1.初試：甄試科目及配分請參閱員額需求表。

2.通過初試者視需要於覆試前參加性格特質測驗。

3.覆試：口試作業。

(二)技術類：甄試科目及配分請參閱員額需求表。

1. 各項甄試作業如遇天災、事變及突發事件(如：颱風來襲)等不可抗力之原因，本所得視情況合理的調整甄試作業時間、地點及甄試方式並應即通知應考人員。
2. 各項甄試作業(如：時間、地點…等)均以電子郵件或簡訊通知應考人員。請考生務必留意報考時提供之電子郵件帳號及手機號碼。若以電子郵件或簡訊通知無法聯繫到考生，視為該考生放棄報考，不再另行通知。
3. 研發類筆試或書面審查不合格者及技術類筆試或實作不合格者，皆不通知參加口試。
4. 口試甄試時，若考生未於規定時間內完成報到手續，需主動以電話先行告知，報到時間得視情況順延(1小時內為原則)。

**柒、錄取標準：**

1. 甄試合格標準：
2. 初試單項(書面審查/筆試/實作/口試)成績合格標準請參閱員額需求表，未達合格標準者不予錄取。
3. 覆試(口試)合格標準為70分(滿分100分)
4. 初、覆試總成績合格標準為70分(滿分100分)。
5. 如有其中一項甄試項目缺考者，不予計算總分，且不予錄取。
6. 成績排序：

(一)以總成績高低依序錄取。

1.研發類總成績：總成績為口試覆試平均成績。

2.技術類總成績：總成績為各單項成績依比例計算後加總。

(二)總成績相同時：

1.研發類：依序以初試總成績、口試平均成績、書面審查平均成績較高者為優先；遇所有成績均相同時，由本所決定錄取順序。

2.技術類：依序以實作平均成績、筆試單一成績、口試平均成績較高者為優先；遇所有成績均相同時，由本所決定錄取順序。

1. 備取人數及儲備期限：
2. 招考員額5員(含)以上：備取人數以3員為限。
3. 招考員額4員(含)以下：備取人數以2員為限。
4. 備取人員儲備期限：自甄試結果奉權責長官核批次日起4個月內有效。

**捌、錄取通知：**

1. 甄試結果於甄試完成後一**個月內以電子郵件或簡訊通知**。
2. 人員進用：錄取人員參加權利義務說明會後，再辦理報到作業。錄取人員試用3個月，試用期間經考核為不適任人員，予以資遣並核予資遣費。
3. 人員錄取或遞補後，其他招考職缺之錄取或遞補皆需自動放棄。

**玖、如有任何問題歡迎電詢聯絡人員：**

電子信箱：amethyst1219@ncsist.org.tw

總機：(03)4712201

聯絡人及分機：李日新副組長352229

 丁樂珍小 姐352232

 藍巧茹小 姐352026

附件1

| **國家中山科學研究院飛彈火箭研究所107年第三次專案人力進用員額需求表** |
| --- |
| **工作编號** | **職類** | **學歷需求** | **薪資****範圍** | **專長****(技能)** | **學歷、經歷條件** | **工作內容** | **需求****員額** | **工作地點** | **甄試****方式** |
| 1 | 研發類 | 博士畢業 | 77,250|85,000 | 機械/航空 | 1.機械/航空/造船/土木/應用力學/機電/系統科學/工程科學等相關系所畢業。2.需檢附大學及碩博士各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具結構有限元素分析相關研究工作經驗。(2)具固體力學/結構力學等相關領域之研究經驗。(3)具有結構分析套裝軟體使用實務經驗。(4)具公/民營機構訓練證照或證明。 | 1.結構動態/衝擊/運動等分析。2.複合材料結構分析。3.結構/流體耦合分析。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 2 | 研發類 | 博士畢業 | 77,250|85,000 | 光電/電機/電子 | 1.光電/電機/電子等相關系所畢業。2.需檢附大學及碩博士各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。3.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具Labview、Matlab等儀器控制與自動化編程軟體操作能力或經驗。(2)具微處理器、DSP、FPGA等嵌入式系統開發工作能力或經驗。(3)具光學/電機系統設計與系統模擬模型建立之能力或經驗。(4)具機械繪圖軟體如Solidworks之操作能力。 | 1.光學/機電/液油壓等各式自動化測試系統設計與籌建。2.光學/機電等系統模型建立與模擬分析。3.微處理器/DSP/FPGA整合電路軟硬體設計。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 3 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 工業工程 | 1.工業工程/系統工程等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具專案管理、研發管理、生產管理、品質管理工作經驗1年(含)以上。(2)具各項專案管理技能檢定成績或證照者。 | 專案管理、研發管理、行銷管理、生產管理、營運管理、顧客關係管理等，協調、分析、規劃、整合、決策、推動、稽核等任務。 | 2員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 4 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 資訊 | 1.資訊/計算機/電腦等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：1. 具專案管理工作經驗1年(含)以上。
2. 具J2EE資訊系統開發或資料庫管理等工作經驗1年(含)以上。
3. 具各項專案管理與資訊技能檢定成績或證照者。
 | 1.協助辦理專案管理、研發管理、行銷管理、生產管理、營運管理、顧客關係管理等，協調、分析、規劃、整合、決策、推動、稽核等任務。2.現有J2EE架構之流程架構分析、效能提昇、功能改善、版本審核，以及資料庫Schema設計分析與管理。3.軟體品保與軟體工程發展管理。以及本院資訊整合會議。4.資訊安全政策規劃、推動與稽核。伺服器管理與維護。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 5 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空 | 1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/自動控制/應用力學/動力/飛機/冷凍空調等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具有專案管理/系統 工程/生產管理相關工作經驗。(2)具備MS Office軟體 (含Project)操作能 力。(3)具國家考試資格、技 術士技能檢定等相關 證照/證書。 | 1.飛彈、火箭及相關武器系統裝備的研發、生產和後勤之系統整合，以及硬品產製規劃和管制。2.專案計畫系統工程及計畫管理之推動與管制。 | 2員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 6 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 工業工程/機械 | 1.機械/航太/機電/自動控制/工業工程/工業管理/系統工程等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具物料管理/倉儲管理/專案管理或生產管理等資訊整合經驗者為佳(請檢附證明資料)。 | 1.物料管理與專案計畫執行相關系統介面與資訊整合研究。2.物料進出庫、物流、儲位指派法則建立，物料資訊統計分析研究與管理。 | 2員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**專業筆試40%**：物料管理。(英文合格或免試者始得參加物料管理筆試)。 參考書籍: 物料與倉儲管理，作者：洪振創‧湯玲郎‧李泰琳，高立圖書出版社。**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格)  |
| 7 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空 | 1.機械/車輛/航太/造船/輪機/能源/應用力學/動力等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具推進相關研發工作經驗為佳(請檢附證明資料、推薦函)。 | 1.各型火箭發動機之研發，包括設計、測試、分析等工作。2.系統工程包括系統規劃、分析，介面協調、整合等工作。 | 2員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 8 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空 | 1.機械/車輛/航太/造船/輪機/機電/應用力學/動力/系統工程等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具熱流/燃燒/氣動力/噴射推進等相關領域背景。(2)具熱流實驗/風洞實驗相關工作經驗。 | 1.各型飛行載具/引擎地面試驗之規劃、執行。2.試驗/試驗設備之相關熱流問題分析、評估、研究。 | 2員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 9 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空 | 1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/應用力學/動力/土木/系統工程等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具機械設備設計/加工/製造及產品製程規劃等技術及工作經驗。(2)具結構與機構之動、靜態設計/分析或試驗背景及CAD/CAE 軟體工作經驗。(3)具高壓氣體管線設計/分析/繪圖工作經驗。 | 1.設備結構、機構、關鍵組件及相關裝備設計、開發、分析或試驗相關工作。2.高壓氣體管線之管路規劃、設計繪圖、分析與操作相關工作。 | 2員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 10 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空 | 1.機械/航空/應用力學/造船/機電/系統科學/工程科學等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具熱流相關研發工作經驗。(2)具流體力學/熱流學等相關領域之研究經驗。(3)具有熱流試驗或分析軟體使用工作經驗。(4)具公/民營機構訓練證照或證明。 | 1.熱控制系統設計、分析、高溫熱防護設計、熱傳試驗等工作。2.數值計算網格建立及熱流數值模擬分析。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 11 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空 | 1.機械/航空/應用力學/造船/機電/系統科學/工程科學等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具機械結構設計相關工作經驗1年(含)以上。(2)熟悉下列軟體其中之一:Pro/E、AUTOCAD、SOLIDWORK。(3)具公/民營機構訓練 證照或證明。 | 1.各型彈體結構之設計開發、系統工程等相關工作。2.水下載具結構、機構與關鍵組件設計。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 12 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空 | 1.造船/機械/航空/應用力學/機電/系統科學/工程科學等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具結構試驗、量測技術等相關研究或工作經驗1年(含)以上。(2)具模態測試等相關研究或工作經驗1年(含)以上。(3)熟習Famos、Matlab、 LabView、ME’scope等軟體工具。(4)具公/民營機構訓練證照或證明。 | 1.結構動、靜態試驗及數據分析。2.機構動作測試及數據分析。3.轉動件振動量測及數據分析。4.外地及出海量測等相關工作。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 13 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/電機 | 1.工業工程/機械/電機/車輛/航太/飛機/造船等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具品質工程/量測檢驗/品保相關證照。(2)具軟韌體開發/程式語言使用經驗。(3)具機械或電機檢修能力/常用檢測機儀器使用能力/電腦軟硬體系統使用或維護能力。(4)具國家考試資格/技術士技能檢定合格。 | 1.執行機械、電機類檢驗與測試、測試設備/測試程序規劃與管制。2.品質管理作業規劃、管制與稽核。 | 2員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 14 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/電力/電信/通訊/光電/機電等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具品質工程/量測檢驗與NI測試程式語言/品保相關證照。(2)具電子電路整合設計與檢修能力/常用檢測儀器使用能力/元件市場尋求作業能力。(3)具電力系統測試維護/佈線施工及電力電子訊號量測相關工作經驗。(4)具國家考試資格/技術士技能檢定合格。 | 1.執行電子、電機類檢驗與測試、測試設備/測試程序規劃與管制。2.品質管理作業規劃與管制。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 15 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空/造船/應用力學 | 1.機械/航太/造船/系統工程/應用力學/土木/物理/數學等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具計算流體力學等相關領域之研究工作經驗。(2)具備使用 Fluent/OpenFOAM/STARCCM+等商業軟體經驗。(3)曾修習流體力學/計算流體力學/空氣動力學等相關課程。 | 1.載具外流場計算網格建立及流場數值模擬。2.載具外型設計及運動性能分析等相關工作。3.工程軟體開發。 | 3員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 16 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 控制工程 | 1.電機/航太/自動控制/應用力學/動力等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。(2)具國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。(3)曾修習工程數學與控制工程。(4)具導航系統設計實務經驗。 | 1.控制系統的設計、測試與分析。2.導航系統的設計、測試與分析。 | 2員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 17 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 控制 | 1.航太/機械/電機/電控/應用力學/工程科學/土木/船舶等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.曾修習或具有下列經驗之一(請檢附證明資料)：(1)控制系統分析、設計與模擬。(2)應用力學及流體力學。 | 1.飛行控制系統(自動駕駛儀)設計。2.6-DOF Simulation (六自由度模擬)。 | 2員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 18 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空 | 1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/自動控制/應用力學/動力等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具流體機械設計/測試等相關工作經驗。(2)具組件機構設計/3D繪圖相關工作經驗1年(含)以上。 | 1.機械零組件之設計/測試/分析。2.機構設計/3D繪圖。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 19 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空 | 1.機械/應用力學/航太/造船/動力/系統工程/機電/土木等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/BT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一者為佳(請檢附證明資料)：(1)具Pro/E或Solidworks等3D CAD軟體或具機械設計能力。(2)具有限元素分析軟體使用經驗。(3)具機構分析軟體使用經驗。(4)具液/氣壓系統設計經驗。(5)具公/民營機構訓練證照或證明。 | 執行機械零組件、機構系統及液/氣壓系統的研發設計、分析模擬、製造、組裝、測試驗證等工作。 | 3員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 20 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/控制/電信/光電/資訊工程等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具下列開發經驗之  一：C++/C#/Java/ Linux/Visual Basic/ Matlab/LabVIEW/內嵌式程式。(2)具軟體通信與數位信號處理經驗。(3)具類比、數位電路、單晶片設計經驗。 | 1.軟體/韌體、DSP數位電路及微控制器軟硬體開發研製。2.系統核心設計與測試、系統分析模擬。3.通訊程式、機構控制軟體開發。4.類比伺服控制器電路研製、人機操控介面程式設計。5.電子、電力、通信、系統整合、控制。 | 2員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 21 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/控制/電信/光電/資訊工程等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具微處理器、DSP、FPGA等嵌入式系統開發工作經驗。(2)具C/C++/Java電腦語言能力，撰寫中層驅動界面程式工作經驗。(3)具軟體通信與數位信號處理工作經驗。(4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。 | 1.軟體/韌體、DSP數位電路及微控制器軟硬體開發研製。2.通訊程式、人機操控介面程式或分析軟體設計。3.通信、系統整合、控制軟體開發。4.系統核心設計與測試、系統分析模擬。5.微處理器或FPGA整合電路軟硬體設計。6.測試系統整合設計。 | 3員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 22 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空 | 1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/自動控制/應用力學/動力等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具使用Pro/E、NX或SolidWorks繪圖軟體及自動控制Matlab軟體經驗。(2)具備液/氣壓系統研發計畫或專案開發等相關工作經驗。 | 1.伺服致動器系統機械設計分析與組裝測試。2.液/氣壓伺服控制系統研發及系統工程整合。3.視任務需求，需配合出差執行裝備/系統安裝與測試等相關工作。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 23 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/光電/資訊工程等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具電子/電機/光電/資訊工程相關工作經驗。(2)具C語言或LabVIEW開發經驗、認證。(3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。 | 1.測試器軟硬體開發設計、嵌入式系統應用開發。2.PXI模組化測試系統研發設計。3.類比及數位控制電路設計、分析與驗測。4.電控裝備故障診斷及排除。 | 5員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 24 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/控制/資訊工程等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具電源轉換系統、寬能隙功率元件驅動與功率轉換設計開發等相關工作經驗。(2)具電子電路模擬與設計、DSP韌體撰寫、PCB Layout及測試等相關工作經驗。(3)具控制器開發、車載電池系統開發、儲電系統開發、電池測試等相關工作經驗。 | 1.軍民通用之新世代電源供應系統研製與設計。2.軍民通用之前瞻功率轉換器及電源驅動器之模擬分析、技術開發及整合測試。3.控制器開發、車載電池系統開發、儲電系統開發、電池測試 | 2員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 25 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空 | 1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/自動控制/應用力學/動力等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具Solidworks /Autodesk Inventor 等軟體應用及相關工 作經驗1年(含)以上。(2)具機械設備開發等相關工作經驗1年(含)以上。 | 1.機構及零組件設計及工程分析。2.結構分析。3.專案系統規劃與管理。  | 2員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 26 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空 | 1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/自動控制/應用力學/動力等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具熱流分析/熱流系統/流體機械開發等技術及工作經驗1年(含)以上。(2)具機構、零組件設計及產品研發流程，曾執行相關系統整合、工程設計分析等研發專案相關工作經驗1年(含)以上。(3)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.顆粒運動與多相熱流場分析。2.管/流路設計。3.執行各專案關鍵零組件分析設計。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 27 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/工業工程 | 1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/自動控制/應用力學/動力/工業工程等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具機械設計/加工/製造及產品製程規劃等技術及工作經驗。(2)具產品研發流程/研發專案管制/品質管理等，曾執行系統整合、工程設計/分析/製造或產品認證等研發專案相關工作經驗1年(含)以上。(3)具國際專案管理(PMP)證照。(4)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.執行零件製程開發/管制與品質工程/品質管理等工作。2.執行研發專案規劃與專案管制等工作。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 28 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械 | 1.機械/動力機械/車輛/航太(空)/造船/輪機/模具/製造/機電/應用力學/動力等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具備3D機械設計繪圖學經歷。(2)具機械設計/加工/製造及產品製程規劃等技術及工作經驗。(3)具機械設備開發等相關工作經驗1年(含)以上。 | 1.CAD圖檔管理暨3D輕量化圖檔同步工程運用2.3D輕量化圖檔虛擬實境視覺化運用3.CAD/CAM圖資整合暨自動化產製資源管理運用 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 29 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空  | 1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/自動控制/應用力學/動力等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具機械設計/加工/製造及產品製程規劃等技術及工作經驗。(2)具機械設備開發等相關工作經驗1年(含)以上。(3)具備CAD/CAM製程設計經驗。(4)具備航太零組件設計與機械製造實務經驗。(5)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 機械設計、加工、製造及產品製程規劃、生產管制與規劃等工作。 | 8員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 30 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 機械/航空 | 1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/自動控制/應用力學/動力等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具精密機械設備、產品設計、零組件製程規劃、品質驗測等工作經驗。(2)具液壓設備或組件測試設備開發及測試程式設計規劃撰寫等相關工作經驗1年(含)以上。(3)具備CAD/CAM製程設計經驗。(4)具備Solid Works軟體使用能力。 | 1.精密液壓組件、超低溫致冷器研發，含籌料、零件製造、組件組裝、總成測試等技術開發。2.機械設計製造、製程規劃、產能籌建、測試分析等產製工作。 | 4員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 31 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650|65,000 | 工業工程/機械/航空/電機/電子/數學/物理/化學/材料 | 1.機械/航空/航太/電機/電子/光電/材料/物理/化學/數學/工業工程/系統工程等相關系所畢業。2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/ PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。3.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具軌道力學/推進系統等相關研究經驗。(2)具太空元件設計/分析/試驗等相關經驗。(3)具專案管理、系統工程管理等相關經驗。(4)具專案品保/產品或系統測試等相關經驗。 | 1.系統分析設計/系統工程整合/系統組測管理。2.專案測試與評估。3.專案管理。4.專案品保。 | 2員 | 桃園龍潭 | **初試：****筆試：**英文(60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）**書面審查40%**(70分合格，合格者方可參加口試)**口試60%**(70分合格)**複試：****口試100%**(70分合格) |
| 32 | 技術類 | 大學畢業 | 38,110|45,000 | 專案管理 | 1.資訊/工業工程等相關科系畢業。2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具採購或專案管理工作經驗1年(含)以上。(2)具J2EE資訊系統開發或資料庫管理等工作經驗1年(含)以上。(3)具採購、專案管理或資訊相關技能檢定或證照。 | 1.專案計畫之預算管理、進度管制、風險管理、績效評鑑(內稽)、固定資產投資、人(機)力工時、組織編裝、營業秘密管理、核心能量及技術發展地圖、先期研究發展計畫、國內外展示行銷、後勤維持工程、軍種委託服務、採購等與經營管理有關事務。2.J2EE架構之網頁維護、Java與JSP程式撰寫、SQL資料庫資料管理。3.執行資安檢查、伺服器維護及資訊軟(硬)體相關業務。 | 3員 | 桃園龍潭 | **筆試60%：**專案管理**參考書籍：**專案管理基礎知識與應用實務。作者：許秀影等人。出版社：社團法人中華專案管理學會)(70分合格，合格者方可參加口試)**口試 40%**(70分合格) |
| 33 | 技術類 | 專科畢業 | 36,050|42,000 | 生產排程 | 1.機械/工業工程等相關科系畢業。2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)可茲佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。(如AutoCAD、 SolidWorks) (2)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。(3)行政院公共工程委員會「採購專業人員基礎訓練」證照。(4)專科各學年成績單。(5)具生產管理、採購作業、專案管理工作經驗1年(含)以上。(6)具機械製圖軟體使用經驗。 | 1.生產製造及排程管制、協調。2.辦理計畫管制業務。3.生產資料建立與進度管制業務。4.文件彙整與技術手冊編撰。5.辦理採購相關業務。6.協助工程圖形態管制。 | 1員 | 桃園龍潭 | **筆試60%：**Word 2013、Excel 2013，(請參考WORD、EXCEL應用軟體說明)(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| 34 | 技術類 | 大學畢業 | 38,110|45,000 | 物料管理 | 1.資訊/機械/航太/機電/自動控制等相關科系畢業且具物料管理相關工作經驗1年(含)以上；非上列相關科系畢業者，需具物料/物流管理相關工作經驗2年(含)以上 (請檢附證明資料)。2.熟悉Excel之資料彙整分析等操作。3.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具備倉儲管理實務經驗。(2)具物管實務經驗。(3)具SQL資料庫程式 語法操作實務經驗。 | 1.物料資料分析。2.倉儲管理作業。3.其他物料管理及採購業務。 | 1員 | 桃園龍潭 | **筆試60%：**Excel操作**參考書籍：**Excel 2013在辦公室管理上的應用(70分合格，合格者方可參加口試)**口試 40%**(70分合格) |
| 35 | 技術類 | 專科畢業 | 36,050|42,000 | 機械 | 1.機械相關科系畢業且具機械加工相關工作經驗1年(含)以上；非機械相關科系畢業者，需具機械加工相關工作經驗2年(含)以上 (請檢附證明資料)。2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具機械相關乙級(含)以上技術士證照。 (2)具三噸以上固定式起重機和一噸以上堆高機訓練合格證書。(3)具工具機操作工作經驗。  | 1.鋸床操作。2.水刀切割機操作。3.剪床操作。4.其他物料倉儲管理及採購業務。 | 1員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**鋸床 **實作範圍：**機械操作金屬裁切(70分合格，合格者方可參加口試)**口試 40%**(70分合格) |
| 36 | 技術類 | 高中(職)畢業 | 30,900|37,000 | 補給 | 1.商經/國貿/會計/資處/資訊/電子/電機/控制/機械/商用英文/普通科等相關科系畢業且具倉管/物管相關工作經驗1年(含)以上 (請檢附證明資料)。2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)物料管理相關證照或研習證明。 (2)具三噸以上固定式起重機訓練合格證書。(3)具一噸以上堆高機訓練合格證書。 | 1.倉儲管理業務，包含入出庫及庫房管理相關作業。2.料件管理及採購作業。 | 1員 | 桃園龍潭 | **筆試60%：**物料與倉儲管理**參考書籍:** 物料與倉儲管理，作者：洪振創‧湯玲郎‧李泰琳，高立圖書出版社。)(70分合格，合格者方可參加口試) **口試40%**(70分合格) |
| 37 | 技術類 | 大 學畢業 | 38,110|45,000 | 化學/化工 | 1.化學/化工/環工等相關科系畢業。2.需具毒化物乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。3.具物管實務相關經驗為佳(請檢附證明資料)。 | 1.化學材料庫儲管理，及其他五金料(扣)件庫儲管理。2.物料系統帳務處理及統計分析。 | 1員 | 桃園龍潭 | **筆試60%：**普通化學**參考書籍：**普通化學作者：楊永華等4人出版社：三民書局)(70分合格，合格者方可參加口試)**口試 40%**(70分合格) |
| 38 | 技術類 | 大學畢業 | 38,110|45,000 | 機械繪圖 | 1.機械/航空/車輛/繪圖/電腦輔助設計等相關科系畢業。2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具PRO/E、Solid- Works、Auto-Cad、Solid Edge等繪圖與設計能力。(2)具機械類電腦繪圖乙級證照。(3)具PRO/E、AUTOCAD、SOLIDWORKS等繪圖 與設計能力。1. 具有全民英檢、TOEIC

、托福等相關英文成績證明。 | 1.操控系統機櫃(構)設計與繪圖。2.機械加工夾治具設計與繪圖。3.3D/2D機械設計、藍圖繪製及圖檔整合相關工作。4.Bom表建立與相關工件管理籌獲5.CAD/CAM轉換之3D圖資編修作業。6.馬達柱塞泵驗收測試、現場機械組裝測試。 | 5員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**Solidworks軟體操作 (70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| 39 | 技術類 | 大學畢業 | 38,110|45,000 | 機械檢驗與品管 | 1. 機械/航空等相關科系畢業；其他理工科系畢業者，需具機械相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。

2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具機械類加工製造檢驗、機械識圖與品質管制/檢驗工作經驗或技術士技能檢定相關證照。(2)具三次元量床操作及程式撰寫經驗。 | 1.精密機械零組件檢驗、機械性能等檢驗及品質管制工作。 2.執行機械零扣件進料檢驗。 | 6員 | 桃園龍潭 | **筆試60%：**機械視圖與品質管理**參考書籍:**1.品質管制(中興管理顧問公司發行劉振譯)或一般品質管制書籍2.幾何尺寸與公差(中央圖書出版社 許兆年、詹安仁、 林榮慶編譯)3.抽樣檢驗(中華民國品質學會張有成編著)或其它抽樣檢驗書籍(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| 40 | 技術類 | 大學畢業 | 38,110|45,000 | 機械測試 | 1.機械/航空/機電/應用力學/材料/車輛/造船/輪機等相關科系畢業。2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具壓力容器檢測人員相關證照。(2)具品保(管)人員相關證照。(3)具機械組裝、品保(管)檢測相關工作經歷。 | 1.各類壓力容器及噴嘴組等硬品液壓氣密功能測試。2.品質文件資料建立及實驗室認證系統維護。 | 2員 | 桃園龍潭 | **筆試60%：**壓力容器耐壓及洩漏試驗概論**參考書籍：**CNS 9801CNS 10216(中華民國國家標準)(70分合格，合格者方可參加口試)**口試 40%**(70分合格) |
| 41 | 技術類 | 大學畢業 | 38,110|45,000 | 機械非破壞檢測 | 1.機械/航空/機電/應用力學/材料/車輛/造船/輪機等相關科系畢業。2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具輻射防護員資格或輻射安全證書執照或測驗成績及格通知書。(2)具非破壞檢測人員證照。(3)具品保(管)、非破壞檢驗工作經歷。 | 1.銲接件、金屬鑄件及複合材料等硬品道次非破壞檢驗。2.品質文件資料建立及工件接件、轉出作業。 | 1員 | 桃園龍潭 | **筆試60%：**非破壞檢測**參考書籍：**射線檢測法(初、中級)(財團法人非破壞檢測協會出版)超音波檢測法(初、中級)(財團法人非破壞檢測協會出版)液滲檢測法(初、中級)(財團法人非破壞檢測協會出版)(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| 42 | 技術類 | 大學畢業 | 38,110|45,000 | 機械測量 | 1.機械/航空/土木/測繪(量)/空間資訊/建築/材料/電機(子)/機電/車輛/造船/輪機等相關科系畢業。2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具接觸式尺碼檢驗工作經驗。(2)具空間/大地測量或物性量測工作經驗。(3)具光學/電子經緯儀/雷射追蹤儀或其他類似空間量測儀器操作能力與經驗。(4)具機械設計/(電腦輔助)機械製圖/品質管制(理)/品質檢驗等工作經驗或相關技術士技能檢定證照。 | 1.機械零組件檢驗及品質管制工作。2.使用經緯儀/雷射追蹤儀或其他類似空間量測儀器執行空間/大地/航空器/船舶/設施工程測量工作。3.使用重量量測機具與慣性儀等儀器執行物性量測工作。4.具機械設計與繪圖能力，可設計檢測夾治具。 | 2員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**量測儀具操作**實作範圍：**1. 接觸式尺碼檢驗機儀具操作
2. 空間量測儀器操作與數值判讀
3. 特理特性量測儀器操作與數值判讀或計算

實作所需使用儀器均由考試單位準備(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| 43 | 技術類 | 高中(職)畢業 | 30,900|37,000 | 光纖熔接 | 1.電子/電機/電力控制/資訊/機械等相關科系畢業。其他理工科系畢業者，需具電子電機或機械相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。2.具光纖光學零組件組裝與測試相關工作1年以上為佳(請檢附證明資料)。 | 1.光纖光學組件組裝與測試2.光纖熔接機台維護3.導航系統模組測試、與測試機台維護 | 2員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**光纖熔接**實作範圍：**1.125μm光纖熔接2.80μm光纖熔接3.PM光纖熔接(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| 44 | 技術類 | 大學畢業 | 38,110|45,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/電力控制等相關科系畢業。其它理工科系畢業者，需具電子/電機相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具基本電路設計經驗。(2)具公/民營機構訓練證照或證明。(3)具丙級以上電機電子類技術士證照(4)具有職業安全衛生管理等相關經驗。(5)具室內配線或電路板錫焊工作經驗1年(含)以上。(6)具備MS Office軟體操作能力。 | 1.電路製作、電子零件錫焊、電路板、設備及訊號線檢修及線束接頭製作。2.協助試驗組裝、線束測試、通聯與試驗儀器操作及保養、佈線施工、電力訊號量測及維護。3.外地及出海量測相關工作。5.各項任務裝備系統安裝、測試等相關工作。 | 10員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**錫銲**實作範圍：**含基本電子元件辨識、電路銲接與儀表操作(70分合格，合格者方可參加口試)注意：應試者需自備鉗子、電烙鐵、焊錫、數位電表…等工具**口試40%**(70分合格) |
| 45 | 技術類 | 大學畢業 | 38,110|45,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機等相關科系畢業。2.需檢附專科各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)。3.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具電子電路相關工作經驗。(2)具電路板檢驗及電路板相關試驗分析工作經驗。(3)具電路板檢測分析工具之工作經驗。 | 1.電路板檢驗及分析。2.電路板相關測試工作。3.表面處理檢驗工作。 | 1員 | 桃園龍潭 | **實作60%**：電路裸板檢驗(70分合格，合格者方可參加口試)**口試 40%**(70分合格) |
| 46 | 技術類 | 高中(職)畢業 | 30,900|37,000 | 鉗工 | 1.機械/航空等相關科系畢業；其他理工科系畢業者，需具機械相關乙級技術士證照。2.具機械類鉗工或航空修護工作經驗2年(含)以上(請檢附證明資料)。3.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具渦輪引擎維修或組裝經驗。(2)具液壓測試設備或動平衡工作經驗。(3)具機械零組件採購或物料管理/生產管理實務經驗。 | 1.執行渦輪引擎動平衡、相關零組件之鉗/銑加工修配、組裝與測試工作。2.協助辦理零組件籌購與物料管理業務。 | 3員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**鉗工及轉動件動平衡**實作範圍：**組裝鉗工、轉動件動平衝(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%** (70分合格) |
| 47 | 技術類 | 專科畢業 | 36,050|42,000 | 鈑金 | 1.機械/鈑金/冷作等相關科系畢業。2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具鈑金/冷作相關丙級(含)以上技術士證照。(2)具鈑金或冷作工作經驗2年(含)以上。 | 1.鈑金折彎、旋壓及捲製成型工作。2.各種材料捲管、修配與整型工作。3.電控系統箱櫃、車廂製作、修改與組裝工作。 | 4員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**鈑金或冷作**實作範圍：**鈑金展開技術(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| 48 | 技術類 | 專科畢業 | 36,050|42,000 | 熱處理 | 1.機械/材料等相關科系畢業；其它理工科系畢業者，需具機械相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。2.具熱處理工作經驗1年(含)以上為佳(請檢附證明資料)。  | 1.碳鋼或鉻鉬鋼氣氛熱處理。2.鋁合金與不銹鋼固溶、時效熱處理。3.鈦合金與鎳基合金等真空熱處理。 | 1員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**材料試驗**實作範圍：**材料熱處理程序及硬度測試(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| 49 | 技術類 | 專科畢業 | 36,050|42,000 | 銲接 | 1.機械/電子/電機等相關科系畢業。2.需同時具備下列兩項資格條件(請檢附證明資料)：(1)氬氣鎢極電銲單一級(含)以上技術證照。(2)具銲接工作經驗1年(含)以上。 | 1.鋁合金或不銹鋼工件銲接。2.碳鋼或鉻鉬鋼材料銲接。3.鈦合金與鎳基合金等材料銲接。4.須能配合輪班作業。 | 2員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**銲接**實作範圍：**鋁合金或不銹鋼或碳鋼銲接(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| 50 | 技術類 | 專科畢業 | 36,050|42,000 | 鉗工 | 1.機械相關科系畢業，其它理工科系畢業者，需具機械相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。2.需具下列資格條件之一(請檢附證明資料)：(1)具機械、飛機、液/氣壓、發電機及機械設備等維修、組裝或配管相關工作經驗1年(含)以上。(2)具機械加工(車、銑、鉗、磨床、模具、鈑金)等操作或相關工作經驗1年(含)以上。 (3)具機械加工刀具使用與選取、再生與庫管經驗。3.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)可茲佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。(2)具備藍圖視圖能力。(3)具精密機械組裝或液/氣壓相關工作經驗。(4)具起重機和堆高機訓練合格者。(5)具CAD軟體使用經驗。(6)具鉗工、機電整合、冷凍空調裝修乙級(含) 以上技術士證照。 | 1.各項機械零組件加工。2.各項裝備的組裝、使用、維修、保養、整備、安裝、調校、測試等工作。3.委製、設備維修、刀工具等購案作業。4.辦理採購相關業務。5.文件彙整與技術手冊編撰。6.液壓系統使用、維修、保養，和油管(軟管和硬管)製作維修。7.發電機與冷凍空調檢修及維護。 | 10員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**鉗工**實作範圍：**組裝鉗工(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%** (70分合格) |
| 51 | 技術類 | 專科畢業 | 36,050|42,000 | 銑工 | 1.機械相關科系畢業；其它理工科系畢業者，需具CNC或傳統銑床乙級(含)以上技術士證照(請檢附證照影本)。2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具操作銑床或電路板製作加工經驗1年(含)以上。(2)具備製程規劃與藍圖視圖能力。(3)CNC或傳統銑床乙級(含)以上技術士證照。 | 1.武器系統各機械零組件銑床加工等相關工作。2.CNC銑床加工程式撰寫等相關工作。3.計畫專案生產作業。4.電路板鑽孔製程、電路板成型製程加工。5.機械模夾具加工。6.複合材料工件銑床加工。 | 12員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**銑工**實作範圍：**NC銑床加工(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| 52 | 技術類 | 專科畢業 | 36,050|42,000 | 車床 | 1.機械相關科系畢業；其它理工科系畢業者，需具CNC或傳統車床乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具操作車床加工經驗或曾於公立職訓中心受訓。(2)具備製程規劃與藍圖視圖能力。(3)具CNC或傳統車床乙級(含)以上技術士證照。 | 1.武器系統各機械零組件車床加工等相關工作。2.CNC車床加工程式撰寫等相關工作。 | 6員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**大車床實作**實作範圍：**傳統或NC車床加工(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| 53 | 技術類 | 專科畢業 | 36,050|42,000 | 車床 | 1.機械相關科系畢業，其它理工科系畢業者，需具機械加工類相關乙級技術士證照(請檢附證明資料)。2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具機械加工相關工作經驗1年(含)以上。(2)具車床類、銑床類技術證照為佳。(3)具備製程規劃與藍圖視圖能力。 | 1. 精密傳統、CNC車床、CNC銑床加工、程式撰寫。
2. 精密零件製作。
3. 精密慣性儀具零件製作、組裝測試。
4. 複合材料、模夾具車床加工。
5. 機械模組組裝、修配及測試。
 | 6員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**中小車床實作**實作範圍：**傳統或NC車床加工(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| 54 | 技術類 | 大學畢業 | 38,110|45,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機等相關科系畢業。2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：(1)具Labview儀器控制與自動化編程軟體操作能力或經驗。(2)具備微處理器、DSP、FPGA等嵌入式系統開發工作能力或經驗。 | 1.光學/機電/液油壓等各式自動化測試系統程式撰寫2.微處理器/DSP/FPGA整合電路軟硬體設計與製作。 | 1員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**(以下二選一)(1)Labview程式撰寫。(2)Keil C程式撰寫。(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| 55 | 技術類 | 專科畢業 | 36,050|42,000 | 機械 | 1.機械相關科系畢業；其它理工科系畢業者，需具機械相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。2.具CNC線切割、放電加工相關工作經驗(請檢附證明資料)。 | 1.機械或精密另件線切割及放電加工製造。2.武器系統各機械零組件CNC線切割加工等相關工作。 | 1員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**線切割操作 **實作範圍：**AGIE CNC線切割機(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| 56 | 技術類 | 專科畢業 | 36,050|42,000 | 電鍍蝕刻 | 1.化學/化工等相關科系畢業；其它理工科系畢業者，需具化學/化工相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。2.具化學/化工相關乙級技術士證照或印刷電路板加工相關經驗者為佳(請檢附證明資料)。 | 1.印刷電路板一銅及二銅電鍍作業。2.印刷電路板蝕刻、剝膜、剝錫及其他相關製程。 | 2員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**電路板影像轉移**實作範圍：**電路板線路蝕刻實作(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| 57 | 技術員 | 專科畢業 | 36,050|42,000 | 電鍍 | 1.化學/化工等相關科系畢業；其它理工科系畢業者，需具化學/化工相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。2具電鍍及鋁合金陽極處理作業經驗者為佳(請檢附證明資料)。 | 1.電鍍作業。2.鋁合金陽極處理作業。 | 4員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**電鍍作業**實作範圍：**電鍍鎳實作(70分合格，合格者方可參加口試)**口試40%**(70分合格) |
| 合計：研發類64員、技術類89員，共計153員。 |

附件2

**履　　　　　歷　　　　　表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★姓名 |  | 英文姓名 |  | ★身分證號碼 |  | 最近三個月1吋半身脫帽照片 |
| 出生地 |  | ★出生日期 | 年月日 | 婚姻 | □已婚 □未婚 |
| ★兵役狀況 | □役畢□免役□未役□服役中(退役時間：　　　　　) |
| ★電子郵件 |  |
| ★通訊處 | 戶籍地址 |  | 行動電話 |  |
| 通訊地址 |  | 連絡電話 |  |
| 居住國外在台聯絡人員(緊急聯絡人) |  | 行動電話 |  | 連絡電話 |  |
| ★學歷 | 學校名稱 | 院系科別 | 學位 | 起迄時間 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 註：學歷欄按所獲學位，由高至低順序填寫(例：按博士－＞碩士－＞學士順序)。 |
| ★經歷 | 服務機關名稱 | 職稱(工作內容) | 起迄時間 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 家庭狀況★ | 稱謂 | 姓名  | 職業 | 服務機關 | 連絡(行動)電話 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **□是 有在中科院任職之親屬及朋友者請填寫以下欄位 □否 以下欄位不需填寫** |
| 三親等親屬及朋友在中科院任職之★ | 關係(稱謂) | 姓名  | 單位 | 職稱 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 身體 | 身高：　　　　　　　公分 | 體重：　　 　　　公斤 | 血型： 　　　型 |
| 其他 | 原住民 | □山地 □平地 | 族 別：　　　 　　　　　族 |
| 身心障礙 | 殘障等級：　　　　　　　　　度 | 殘障類別：　　　　　　　　　障(類) |

備註：有★為必填欄位

|  |
| --- |
| 自述(本表若不敷使用請自行延伸) |
|  |

　　　　　　　　　　填表人：　　　 　　　（簽章）

(提醒：請依本履歷規定格式撰寫(含履歷表、自傳及報考項次之學歷、經歷條件需求資料)，視需要可自行增加，整份履歷表必須彙整為一個PDF檔案上載)

**依報考工作編號學歷、經歷條件需求資料，依序自行增修，如未檢附者，視同資格不符**

1. 畢業證書(符合報考職缺學歷要求之畢業證書及最高學歷畢業證書)

(請貼上畢業證書圖檔)

1. 學歷文件(大學成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上大學成績單圖檔)

1. 學歷文件(碩、博士成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上碩、博士成績單圖檔)

1. 英文測驗證明文件(本項視報考工作之編號學歷、經歷條件需求，如全民英檢、多益、托福…等)

(請貼上英文證明文件圖檔)

1. 具各公營機構相關技能訓練證照或證明(請檢附訓練時數300小時以上相關證明)或其它相關證照(本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上證照正反面圖檔)

1. 相關專業工作經歷證明(本項視學歷、經歷條件需求，本項需公司開出之證明文件)

(請貼上工作經歷證明圖檔)

1. 其它補充資料或特殊需求(本項視學歷、經歷條件需求，或補充自身相關專業之專題、論文、獲獎文件…等資料)

附件3

**國家中山科學研究院**

**各類聘雇員工參加招考報名申請表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 現職單位（至二級） | 姓名(身分證號碼) | 職類及級職 | 最高學歷(含科/系/所) |
|  |  |  |  |
| 擬參加甄選單位職缺 |
| 報考單位(或工作編號) | 職類 | 職缺 |
|  |  |  |
| 本人簽章 | 二級單位 | 一級單位主管批示 |
| 電話： |  |  |
| 一級人事單位 |
|  |

備註：非本院現職員工免填。

附件4

國家中山科學研究院特殊領域人才進用作業規定

一、特殊進用適用對象

非理工科系之特殊領域相關科系碩士(含)以上學歷：大學及碩士修滿與特殊領域相關課程24學分且具備特殊領域證照、競賽得名或特殊技能者，得報名參加本院公開招考。

二、相關專業證照、競賽性質、特殊技能等採計條件如附表

附表-特殊領域限制條件採計表

| 特殊領域 | 限制條件 | 內容 | 採計審認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資訊安全 | 資訊管理或應用相關科系碩士(含)以上學歷 | 大學及碩士須修滿與資訊學科相關課程24學分。 | 相關證照、競賽性質、資安技能認定及科技技術年資採計，有疑義由資訊通信研究所及資訊管理中心共同成立審查小組審認之。 |
| 資安國際證照(本項適用對象須具備右列證照至少一項，且證照有效期必須超過招考報名截止日期) | (1)ISO 27001之資訊安全管理系統主導稽核員認證(2)ECSA 資安分析專家認證(3)EDRP 資安災害復原專家認證(4)CCISO 資安長/EISM資安經理人認證(5)CISSP 資訊安全系統專家認證(6)CSSLP 資訊安全軟體開發專家認證(7)CCIE Security 認證(8)RHCA Red Hat Linux系統安全調校認證(9)LPT 滲透測試專家認證(10)Guidance EnCase 國際專業鑑識認證(11)CHFI 資安鑑識調查專家(數位鑑識) |
| 國際重要資安競賽(本項適用對象須具備右列2年內國際資安競賽獲得前10名(含)至少一項) | (1)Defcon CTF Qualifier(2)Plaid CTF(3)Boston Key Party CTF (BKPCTF)(4)HITCON CTF(5)Hack.lu CTF(6)RuCTFe |
| 資安特殊技能 | (1)對資訊安全領域有重要成就或傑出表現(如挖掘重要資訊系統弱點，經正常管道提報，避免重大損害)。(2)曾於Defcon、BlackHat國際重大論壇發表論著。(3)曾挖掘零時差弱點於HITCON ZERODAY或Vulreport經審認發表。 |
| 軟體開發與管理 | 軟體開發與管理相關國際證照(本項適用對象須具備右列證照至少一項，且證照有效期必須超過招考報名截止日期) | (1)OCM：Oracle Certified Master(2)Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD)(3)Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE)(4)Red Hat Certified Engineer(RHCE)(5)Cloudera Certified Administrator for Apache Hadoop(CCAH)(6)Cloudera Certified Professional (CCP Data Engineer)(7)Certified Software Quality Engineer(CSQE)(8)Certified Software Testing Engineer(CSTE)(9)ERP軟體顧問師(ERP Software Consultant)(10)進階ERP規劃師(Advanced ERP Planner)(11)ERP導入顧問師(ERP Implementation Consultant)(12)OMG Certified UML Professional (OCUP) Advanced(13)Certified CMMI for Development Supplement Instructor(14)Certified CMMI Professional(15)BI 企業顧問師(BI Enterprise Consultant)(16)BI 軟體顧問師(BI Software Consultant)(17)BI企業績效管理顧問師(BI performance Management Consultant) | 相關證照認定及科技技術年資採計，有疑義由資訊通信研究所或資訊管理中心成立審查小組審認之。 |

三、一般事項

(一)相關證照、競賽性質、特殊技能認定及科技技術年資採計，有疑義由提出之專業單位成立審查小組審認。

(二)如特殊領域牽涉範圍超出單一專業，則有疑義由提出之專業單位主辦，召集相關單位共同成立審查小組審認。